【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年11月7日(2013.11.7)

【公開番号】特開2012-74508(P2012-74508A)
【公開日】平成24年4月12日(2012.4.12)
【年通号数】公開・登録公報2012-015
【出願番号】特願2010-217654(P2010-217654)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/60　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/60　　３１１Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成25年9月25日(2013.9.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板の側部上面に電子部品を実装する電子部品の実装装置であって、
上記基板の側部下面を支持するバックアップツールと、
このバックアップツールによって側部下面が支持された上記基板の上面に上記電子部品を加圧加熱しながら実装する加圧ツールを具備し、
上記バックアップツールは、上面が長手方向全長にわたって取付け面に形成されたベース部と、上記基板の側部下面を支持する支持面を有し、上記ベース部の上記取付け面に取り付けられるバックアップ部を有し、
上記ベース部には、上記取付け面に開放するとともに、上記長手方向と交差する幅方向に貫通した吸収溝が形成されていることを特徴とする電子部品の実装装置。
【請求項２】
上記ベース部には、上記長手方向に沿う一対の流路が幅方向に離間して形成されていて、この一対の流路の一方と他方とには、供給手段によって上記ベース部を冷却する冷却媒体の流れ方向が逆向きになるよう供給されることを特徴とする請求項１記載の電子部品の実装装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
この発明は、基板の側部上面に電子部品を実装する電子部品の実装装置であって、
上記基板の側部下面を支持するバックアップツールと、
このバックアップツールによって側部下面が支持された上記基板の上面に上記電子部品を加圧加熱しながら実装する加圧ツールを具備し、
上記バックアップツールは、上面が長手方向全長にわたって取付け面に形成されたベース部と、上記基板の側部下面を支持する支持面を有し、上記ベース部の上記取付け面に取り付けられるバックアップ部を有し、
上記ベース部には、上記取付け面に開放するとともに、上記長手方向と交差する幅方向

に貫通した吸収溝が形成されていることを特徴とする電子部品の実装装置にある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
上記ベース部には、上記長手方向に沿う一対の流路が幅方向に離間して形成されていて、この一対の流路の一方と他方とには、供給手段によって上記ベース部を冷却する冷却媒体の流れ方向が逆向きになるよう供給されることが好ましい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図２】
図２

